

電子回路基板生産動向(2007年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 19年 1月 実績	電子回路基板	1,954	79,874	99.7	113.0	1,954	79,874	99.7	113.0
	リジッドプリント配線板	1,282	49,293	98.8	112.4	1,282	49,293	98.8	112.4
	片面プリント配線板	219	1,155	92.0	97.1	219	1,155	92.0	97.1
	両面プリント配線板	595	11,303	105.1	102.8	595	11,303	105.1	102.8
	多層プリント配線板(4層)	235	9,178	88.0	102.8	235	9,178	88.0	102.8
	多層プリント配線板(6-8層)	99	10,933	94.3	117.5	99	10,933	94.3	117.5
	多層プリント配線板(10層以上)	25	4,566	104.2	109.7	25	4,566	104.2	109.7
	ビルドアップ多層配線板	109	12,158	113.5	131.2	109	12,158	113.5	131.2
	フレキシブルプリント配線板	400	10,647	98.5	100.1	400	10,647	98.5	100.1
	片面フレキシブル配線板	170	4,188	86.7	94.5	170	4,188	86.7	94.5
	両面・多層フレキシブル配線板	230	6,459	109.5	104.1	230	6,459	109.5	104.1
	モジュール基板	270	19,785	106.3	123.1	270	19,785	106.3	123.1
	リジッド系モジュール基板	49	12,611	132.4	150.7	49	12,611	132.4	150.7
その他のモジュール基板	220	7,174	101.4	93.0	220	7,174	101.4	93.0	
その他の電子回路基板	2	149	100.0	100.0	2	149	100.0	100.0	
平成 19年 2月 実績	電子回路基板	1,919	80,961	93.8	110.1	3,873	160,835	96.7	111.5
	リジッドプリント配線板	1,297	50,701	94.3	107.2	2,579	99,994	96.5	109.7
	片面プリント配線板	242	1,299	92.4	108.4	461	2,454	92.2	102.8
	両面プリント配線板	561	11,666	95.1	97.0	1,156	22,969	100.0	99.8
	多層プリント配線板(4層)	237	8,783	85.6	92.8	472	17,961	86.8	97.7
	多層プリント配線板(6-8層)	114	11,218	100.0	114.6	213	22,151	97.3	116.0
	多層プリント配線板(10層以上)	25	4,391	86.2	95.8	50	8,957	94.3	102.4
	ビルドアップ多層配線板	118	13,344	113.5	130.2	227	25,502	113.5	130.7
	フレキシブルプリント配線板	389	11,012	90.5	99.4	789	21,659	94.4	99.8
	片面フレキシブル配線板	188	4,171	91.3	92.8	358	8,359	89.1	93.7
	両面・多層フレキシブル配線板	201	6,841	89.7	104.0	431	13,300	99.3	104.0
	モジュール基板	231	19,094	97.1	127.8	501	38,879	101.8	125.3
	リジッド系モジュール基板	51	12,773	150.0	167.0	100	25,384	140.8	158.5
その他のモジュール基板	180	6,321	88.7	86.7	400	13,495	95.2	90.0	
その他の電子回路基板	2	154	100.0	79.4	4	303	100.0	88.3	
平成 19年 3月 実績	電子回路基板	2,095	90,029	95.5	111.1	5,968	250,864	96.3	111.4
	リジッドプリント配線板	1,385	55,621	94.4	108.3	3,964	155,615	95.7	109.2
	片面プリント配線板	240	1,303	84.8	103.4	701	3,757	89.5	103.0
	両面プリント配線板	611	13,449	98.5	106.5	1,767	36,418	99.5	102.1
	多層プリント配線板(4層)	251	10,027	81.8	96.4	723	27,988	85.0	97.2
	多層プリント配線板(6-8層)	126	12,385	106.8	114.7	339	34,536	100.6	115.6
	多層プリント配線板(10層以上)	25	4,484	83.3	86.2	75	13,441	90.4	96.4
	ビルドアップ多層配線板	132	13,973	120.0	126.1	359	39,475	115.8	129.0
	フレキシブルプリント配線板	448	12,498	95.3	102.5	1,237	34,157	94.7	100.8
	片面フレキシブル配線板	207	4,346	91.2	85.0	565	12,705	89.8	90.5
	両面・多層フレキシブル配線板	241	8,152	99.2	115.1	672	21,452	99.3	108.0
	モジュール基板	260	21,750	102.8	126.3	761	60,629	102.1	125.7
	リジッド系モジュール基板	54	14,855	131.7	153.5	154	40,239	137.5	156.6
その他のモジュール基板	206	6,895	97.2	91.4	606	20,390	95.9	90.4	
その他の電子回路基板	2	160	100.0	75.5	6	463	100.0	83.4	
平成 19年 4月 実績	電子回路基板	2,065	84,445	103.5	113.7	8,033	335,309	98.0	112.0
	リジッドプリント配線板	1,351	52,454	100.0	110.2	5,315	208,069	96.8	109.4
	片面プリント配線板	240	1,283	93.8	109.4	941	5,040	90.6	104.6
	両面プリント配線板	593	11,909	102.8	100.4	2,360	48,327	100.3	101.7
	多層プリント配線板(4層)	246	9,512	90.4	102.3	969	37,500	86.3	98.4
	多層プリント配線板(6-8層)	124	11,861	106.0	117.3	463	46,397	102.0	116.0
	多層プリント配線板(10層以上)	21	4,252	65.6	84.2	96	17,693	83.5	93.1
	ビルドアップ多層配線板	127	13,637	129.6	134.9	486	53,112	119.1	130.5
	フレキシブルプリント配線板	433	11,696	102.4	107.1	1,670	45,853	96.6	102.3
	片面フレキシブル配線板	196	4,080	102.6	95.9	761	16,785	92.8	91.8
	両面・多層フレキシブル配線板	236	7,616	101.7	114.2	908	29,068	99.9	109.5
	モジュール基板	280	20,144	127.9	129.5	1,041	80,773	108.0	126.6
	リジッド系モジュール基板	51	12,776	141.7	138.4	205	53,015	138.5	151.8
その他のモジュール基板	228	7,368	124.6	116.5	834	27,758	102.3	96.1	
その他の電子回路基板	2	151	100.0	84.8	8	614	100.0	83.8	

電子回路基板生産動向(2007年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 19年 5月 実績	電子回路基板	2,045	80,484	102.6	108.2	10,078	415,793	98.9	111.2
	リジッドプリント配線板	1,333	48,533	97.9	101.5	6,648	256,602	97.0	107.8
	片面プリント配線板	244	1,250	93.5	104.6	1,185	6,290	91.2	104.6
	両面プリント配線板	594	11,883	102.6	98.7	2,954	60,210	100.8	101.1
	多層プリント配線板(4層)	236	8,398	86.4	88.6	1,205	45,898	86.3	96.5
	多層プリント配線板(6-8層)	116	10,967	100.9	107.2	579	57,364	101.8	114.2
	多層プリント配線板(10層以上)	23	4,223	79.3	87.5	119	21,916	82.6	92.0
	ビルドアップ多層配線板	120	11,812	114.3	117.6	606	64,924	118.1	127.9
	フレキシブルプリント配線板	432	11,976	106.1	111.2	2,102	57,829	98.4	104.0
	片面フレキシブル配線板	186	4,025	102.8	97.8	947	20,810	94.6	92.9
	両面・多層フレキシブル配線板	245	7,951	108.4	119.5	1,153	37,019	101.6	111.5
	モジュール基板	280	19,842	125.6	127.1	1,321	100,615	111.3	126.7
	リジッド系モジュール基板	52	12,832	144.4	141.1	257	65,847	139.7	149.6
その他のモジュール基板	228	7,010	121.9	107.5	1,062	34,768	106.0	98.2	
その他の電子回路基板	1	133	50.0	76.9	9	747	90.0	82.5	
平成 19年 6月 実績	電子回路基板	2,160	80,749	99.8	98.8	12,238	496,542	99.1	109.0
	リジッドプリント配線板	1,423	50,905	97.3	97.4	8,071	307,507	97.1	105.9
	片面プリント配線板	266	1,389	95.7	105.7	1,451	7,679	92.0	104.8
	両面プリント配線板	631	12,687	103.1	100.4	3,585	72,897	101.2	101.0
	多層プリント配線板(4層)	243	8,381	80.7	81.1	1,448	54,279	85.3	93.7
	多層プリント配線板(6-8層)	120	10,277	96.0	91.8	699	67,641	100.7	110.1
	多層プリント配線板(10層以上)	29	5,136	82.9	90.4	148	27,052	82.7	91.7
	ビルドアップ多層配線板	133	13,035	119.8	117.1	739	77,959	118.4	126.0
	フレキシブルプリント配線板	434	12,043	92.3	98.6	2,536	69,872	97.3	103.0
	片面フレキシブル配線板	191	4,156	99.5	89.8	1,138	24,966	95.4	92.4
	両面・多層フレキシブル配線板	242	7,887	86.7	103.9	1,395	44,906	98.7	110.1
	モジュール基板	301	17,624	132.0	103.4	1,622	118,239	114.6	122.6
	リジッド系モジュール基板	46	10,233	102.2	99.9	303	76,080	132.3	140.2
その他のモジュール基板	256	7,391	139.9	108.5	1,318	42,159	111.2	99.9	
その他の電子回路基板	2	177	100.0	106.6	11	924	91.7	86.2	
平成 19年 7月 実績	電子回路基板	2,219	83,536	106.6	104.1	14,457	580,078	100.2	108.3
	リジッドプリント配線板	1,465	51,952	104.2	101.6	9,536	359,459	98.1	105.3
	片面プリント配線板	265	1,339	102.3	106.6	1,716	9,018	93.4	105.0
	両面プリント配線板	635	13,057	106.5	108.1	4,220	85,954	101.9	102.0
	多層プリント配線板(4層)	268	8,568	93.7	90.4	1,716	62,847	86.5	93.3
	多層プリント配線板(6-8層)	137	11,681	116.1	106.3	836	79,322	103.0	109.6
	多層プリント配線板(10層以上)	26	4,139	74.3	76.7	174	31,191	81.3	89.4
	ビルドアップ多層配線板	134	13,168	119.6	110.4	873	91,127	118.6	123.5
	フレキシブルプリント配線板	469	12,462	104.0	105.2	3,005	82,334	98.3	103.4
	片面フレキシブル配線板	205	4,123	112.0	93.0	1,343	29,089	97.6	92.4
	両面・多層フレキシブル配線板	264	8,339	98.5	112.5	1,659	53,245	98.6	110.5
	モジュール基板	283	18,958	127.5	111.1	1,905	137,197	116.4	120.8
	リジッド系モジュール基板	51	12,049	108.5	111.7	354	88,129	128.3	135.5
その他のモジュール基板	232	6,909	132.6	109.9	1,550	49,068	114.0	101.2	
その他の電子回路基板	2	164	66.7	86.8	13	1,088	86.7	86.3	
平成 19年 8月 実績	電子回路基板	2,090	79,447	103.8	97.0	16,547	659,525	100.6	106.8
	リジッドプリント配線板	1,340	46,278	99.5	89.9	10,876	405,737	98.3	103.3
	片面プリント配線板	236	1,199	95.9	102.6	1,952	10,217	93.7	104.7
	両面プリント配線板	586	12,145	101.9	105.1	4,806	98,099	101.9	102.4
	多層プリント配線板(4層)	252	7,843	90.6	75.1	1,968	70,690	87.0	90.8
	多層プリント配線板(6-8層)	118	9,408	108.3	80.0	954	88,730	103.6	105.4
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,846	76.7	76.3	197	35,037	80.7	87.7
	ビルドアップ多層配線板	125	11,837	112.6	102.9	998	102,964	117.8	120.7
	フレキシブルプリント配線板	442	11,765	103.5	105.0	3,447	94,099	98.9	103.6
	片面フレキシブル配線板	202	4,080	117.4	99.4	1,545	33,169	99.8	93.2
	両面・多層フレキシブル配線板	240	7,685	94.1	108.2	1,899	60,930	98.0	110.2
	モジュール基板	306	21,230	129.7	111.4	2,211	158,427	118.0	119.5
	リジッド系モジュール基板	59	13,993	120.4	114.1	413	102,122	127.1	132.1
その他のモジュール基板	247	7,237	132.1	106.7	1,797	56,305	116.2	101.9	
その他の電子回路基板	2	174	100.0	106.1	15	1,262	88.2	88.6	

電子回路基板生産動向(2007年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 19年 9月 実績	電子回路基板	2,115	79,622	98.3	93.7	18,662	739,147	100.4	105.2
	リジッドプリント配線板	1,387	48,978	97.7	91.5	12,263	454,715	98.2	101.9
	片面プリント配線板	245	1,293	98.0	104.2	2,197	11,510	94.2	104.7
	両面プリント配線板	607	12,866	98.2	100.0	5,413	110,965	101.5	102.1
	多層プリント配線板(4層)	265	8,700	93.0	84.0	2,233	79,390	87.7	90.0
	多層プリント配線板(6-8層)	127	9,929	106.7	84.3	1,081	98,659	103.9	102.8
	多層プリント配線板(10層以上)	23	4,143	74.2	79.8	220	39,180	80.0	86.8
	ビルドアップ多層配線板	119	12,047	101.7	99.4	1,117	115,011	115.9	118.0
	フレキシブルプリント配線板	445	11,323	95.9	94.0	3,892	105,422	98.6	102.4
	片面フレキシブル配線板	206	4,070	110.2	91.3	1,751	37,239	100.9	93.0
	両面・多層フレキシブル配線板	239	7,253	86.3	95.5	2,138	68,183	96.6	108.4
	モジュール基板	281	19,131	105.6	99.4	2,492	177,558	116.5	116.9
	リジッド系モジュール基板	53	12,374	120.5	106.4	466	114,496	126.3	128.7
その他のモジュール基板	228	6,757	103.2	88.6	2,025	63,062	114.5	100.3	
その他の電子回路基板	2	190	100.0	113.1	17	1,452	89.5	91.1	
平成 19年 10月 実績	電子回路基板	2,291	91,713	104.6	103.9	20,953	830,860	100.8	105.0
	リジッドプリント配線板	1,523	58,167	104.5	104.3	13,786	512,882	98.9	102.1
	片面プリント配線板	269	1,401	100.4	114.5	2,466	12,911	94.8	105.7
	両面プリント配線板	651	13,154	103.0	99.8	6,064	124,119	101.7	101.8
	多層プリント配線板(4層)	291	11,029	100.3	99.1	2,524	90,419	89.0	91.0
	多層プリント配線板(6-8層)	148	14,083	125.4	113.9	1,229	112,742	106.1	104.1
	多層プリント配線板(10層以上)	26	4,747	92.9	91.2	246	43,927	81.2	87.3
	ビルドアップ多層配線板	139	13,753	114.9	108.6	1,256	128,764	115.8	117.0
	フレキシブルプリント配線板	478	12,278	104.6	101.6	4,370	117,700	99.2	102.3
	片面フレキシブル配線板	208	4,070	109.5	89.5	1,959	41,309	101.8	92.7
	両面・多層フレキシブル配線板	270	8,208	101.1	109.0	2,408	76,391	97.1	108.5
	モジュール基板	287	21,059	105.1	103.8	2,779	198,617	115.2	115.4
	リジッド系モジュール基板	60	14,049	113.2	110.5	526	128,545	124.6	126.5
その他のモジュール基板	226	7,010	102.7	92.4	2,251	70,072	113.2	99.4	
その他の電子回路基板	3	209	150.0	142.2	20	1,661	95.2	95.5	
平成 19年 11月 実績	電子回路基板	2,286	88,211	107.0	100.5	23,239	919,071	101.4	104.6
	リジッドプリント配線板	1,499	56,124	106.5	102.5	15,285	569,006	99.6	102.2
	片面プリント配線板	247	1,357	95.0	111.9	2,713	14,268	94.8	106.2
	両面プリント配線板	664	13,284	109.6	106.9	6,728	137,403	102.4	102.3
	多層プリント配線板(4層)	288	9,927	104.0	91.8	2,812	100,346	90.3	91.1
	多層プリント配線板(6-8層)	135	12,663	111.6	98.0	1,364	125,405	106.6	103.5
	多層プリント配線板(10層以上)	27	4,827	90.0	92.1	273	48,754	82.0	87.7
	ビルドアップ多層配線板	139	14,056	123.0	115.6	1,395	142,820	116.4	116.8
	フレキシブルプリント配線板	490	11,911	108.6	103.3	4,860	129,611	100.1	102.4
	片面フレキシブル配線板	205	3,606	106.2	76.9	2,164	44,915	102.2	91.2
	両面・多層フレキシブル配線板	285	8,305	110.5	121.4	2,693	84,696	98.3	109.6
	モジュール基板	295	19,976	106.9	93.4	3,074	218,593	114.4	113.0
	リジッド系モジュール基板	61	13,147	113.0	97.4	587	141,692	123.3	123.1
その他のモジュール基板	233	6,829	105.0	86.6	2,484	76,901	112.4	98.1	
その他の電子回路基板	2	200	100.0	139.9	22	1,861	95.7	98.8	
平成 19年 12月 実績	電子回路基板	2,107	83,315	104.8	99.4	25,346	1,002,386	101.7	104.1
	リジッドプリント配線板	1,361	53,917	104.1	104.8	16,646	622,923	99.9	102.4
	片面プリント配線板	223	1,281	94.5	109.5	2,936	15,549	94.8	106.5
	両面プリント配線板	600	12,509	103.8	107.4	7,328	149,912	102.5	102.7
	多層プリント配線板(4層)	259	9,515	101.2	93.1	3,071	109,861	91.2	91.3
	多層プリント配線板(6-8層)	128	12,446	114.3	97.5	1,492	137,851	107.4	102.9
	多層プリント配線板(10層以上)	26	4,616	89.7	91.8	299	53,370	82.6	88.1
	ビルドアップ多層配線板	125	13,550	130.2	127.5	1,520	156,370	117.4	117.7
	フレキシブルプリント配線板	445	11,440	107.0	106.3	5,305	141,051	100.7	102.7
	片面フレキシブル配線板	193	3,695	108.4	83.5	2,357	48,610	102.7	90.5
	両面・多層フレキシブル配線板	252	7,745	105.9	122.2	2,945	92,441	99.0	110.6
	モジュール基板	298	17,777	104.9	82.8	3,372	236,370	113.4	109.9
	リジッド系モジュール基板	53	11,009	101.9	81.5	640	152,701	120.8	118.7
その他のモジュール基板	245	6,768	105.6	85.0	2,729	83,669	111.7	96.9	
その他の電子回路基板	2	181	66.7	106.5	24	2,042	85.7	99.5	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2008/06/30 発表 / 2009/01/30 JPCA修正作成)

(注) 平成18年の月報の数値が一部訂正された年報値が発表されたので、平成19年1月～3月の前年同期比を修正しています。